

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

一、限制性股票激励计划分配情况表

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数比例	占本激励计划公告日股本总额比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员（10人）					
HUI WANG	美国	董事长、 核心技术人员	125.0000	9.3914%	0.2883%
王坚	中国	董事、总经理、 核心技术人员	93.0000	6.9872%	0.2145%
HAIPING DUN	中国台湾	董事	2.0000	0.1503%	0.0046%
罗千里	中国台湾	董事	2.0000	0.1503%	0.0046%
STEPHEN SUN- HAI CHIAO	美国	董事	2.0000	0.1503%	0.0046%
陈福平	中国	副总经理、 核心技术人员	72.0000	5.4095%	0.1661%
LISA YI LU FENG	美国	财务负责人	31.0000	2.3291%	0.0715%
罗明珠	中国	董事会秘书	31.0000	2.3291%	0.0715%
李学军	中国	核心技术人员	15.0000	1.1270%	0.0346%
王俊	中国	核心技术人员	15.0000	1.1270%	0.0346%
二、董事会认为需要激励的其他人员（505人）					
核心管理（业务）骨干、中层管理（业务）人员、优秀基层技术（业务）员工			676.8500	50.8527%	1.5612%
首次授予合计（515人）			1,064.8500	80.0038%	2.4561%
三、预留部分			266.1500	19.9962%	0.6139%
合计			1,331.0000	100.0000%	3.0700%

二、相关说明

1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总

数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

2、本计划激励的激励对象不包括公司独立董事、监事。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月26日